公司代码:688209　　公司简称:英集芯

深圳英集芯科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容,请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为124,250,617.15元,截至2024年12月31日,母公司期末可供分配利润为480,882,091.79元。经董事会决议,本次利润分配方案如下:

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至本报告披露日,公司总股本429,238,405股,以扣除公司回购专用证券账户中股份数3,980,907股后的股本425,257,498股为基数,以此计算合计派发现金红利38,273,174.82元(含税),占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.80%。2024年度公司不送红股,不进行资本公积转增。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整,并将另行公告具体调整情况。

公司2024年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,该利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	英集芯	688209	/

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴任超	陈文琪
联系地址	珠海市香洲区唐家湾镇港湾1号港7栋三楼	珠海市香洲区唐家湾镇港湾1号港7栋三楼
电话	0756-3393868	0756-3393868
传真	0756-3393801	0756-3393801
电子信箱	zqb@injoinic.com	zqb@injoinic.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于高性能、高品质数模混合集成电路研发与销售的芯片公司,涵盖电源管理和快充协议两大领域。产品广泛应用于消费类电子、智能可穿戴设备、光伏新能源、锂电池储能、物联网、通讯设备、汽车电子等众多领域。公司利用数模混合的优势技术,在单芯片集成各种丰富功能,响应客户需求提供高集成、高性价比且能灵活配置的电源管理SoC芯片,快速发展成为国内主要的电源管理芯片供应商之一。公司未来将持续耕耘锂电池相关的应用市场,拓展布局低功耗物联网、新能源、汽车电子、智能音频处理、智能家居等新方向。

2.2主要经营模式

报告期内,公司经营模式无重大变化。公司采用Fabless的经营模式,主要从事芯片的设计与销售,将晶圆制造、封装、测试等生产环节交由晶圆制造厂商和封装测试厂商完成。在此模式下,有助于公司深耕研发创新,聚焦行业发展新动态,推出性能优良、竞争力强的产品。

1、研发模式

公司始终将芯片的设计研发作为公司运营活动的核心。公司紧密跟随市场的变化趋势,将市场动态与客户需求通过一系列研发工作转化成性能优良、竞争力强的产品,并不断进行产品更新迭代,拓展产品的应用领域,以满足不断发展的市场需求。

公司的产品研发按照公司规定的流程严格管控,具体研发流程包括项目立项、方案开发、项目开发、项目验证(样片测试)、项目量产、项目结项等阶段。

2、采购及生产模式

公司专注于芯片的研发和销售,通过委托晶圆厂和封测厂外协加工完成晶圆制造和封装测试,公司自身仅从事部分芯片的测试工作。该模式具有技术驱动,灵活高效等特点。

在Fabless模式中,公司主要进行芯片产品的研发、销售与质量管控,产品的生产则采用委外加工的模式完成,即公司将自主研发设计的集成电路数据交由晶圆厂进行晶圆制造,随后将制造完成的晶圆交由封测厂进行封装和测试。目前,公司采购的内容主要为晶圆和其相关的封装及测试服务,公司的晶圆代工厂商和封装测试服务供应商主要为行业知名企业。

3、销售模式

公司目前采用“经销为主,直销为辅”的销售模式,即公司既通过经销商销售产品,又向终端厂商直接销售产品。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司主营业务是电源管理芯片和快充协议芯片的研发和销售。公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业(I65)。根据《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017)》,公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”(代码:6520)。

(2)行业发展情况

1)全球半导体行业发展态势

在全球数字化转型的大趋势下,半导体行业作为信息技术产业的基石,正处于快速发展阶段。随着5G通信、物联网、人工智能、大数据等新兴技术的广泛应用,半导体芯片的市场需求呈现出爆发式增长。根据美国半导体行业协会(SIA)数据,2024年全球半导体销售额达到6,276亿美元,同比增长19.1%,首次突破6,000亿美元大关。公司所处的电源管理芯片及快充协议芯片细分领域,因各类智能设备对高效电源管理和快速充电功能的需求不断提升,迎来了广阔的发展空间。

2)我国半导体产业发展现状

我国作为全球最大的半导体消费市场,半导体产业发展迅速。根据中商产业研究院发布的数据显示,2024年中国集成电路产业销售额收入预计达12,976.9亿元。但在高端芯片技术方面,仍与国际先进水平存在一定差距,高端芯片进口依赖度较高,这为国内半导体企业在中低端市场及部分新兴应用领域的发展提供了机遇。在电源管理芯片领域,国内企业不断加大研发投入,技术水平逐步提升,市场份额也在稳步扩大。根据中商产业研究院分析师预测,2024年中国电源管理芯片市场规模将达到1,452亿元。公司凭借在数模混合芯片设计方面的技术优势,在国内电源管理芯片和快充协议芯片市场占据了一定地位。

3)行业的发展机遇

随着5G、物联网、人工智能等新兴技术的快速发展,各类智能设备、物联网终端、数据中心等对电源管理芯片和快充协议芯片的需求持续攀升。这些新兴应用领域对芯片的性能、功耗、集成度等方面提出了更高要求,为公司提供了广阔的市场空间。例如,在物联网设备中,需要低功耗、高可靠性的电源管理芯片来延长设备续航时间;在5G基站中,需要高效的电源管理芯片来降低能耗。公司可以凭借在数模混合芯片设计方面的技术优势,开发出满足这些新兴应用需求的产品。

由于集成电路产业外部环境的复杂和不确定性,我国加快了半导体产业国产替代的步伐。政府出台了一系列政策支持国内半导体企业发展,包括税收优惠、研发补贴、产业基金扶持等。在这种背景下,国内下游企业对国产芯片的接受度逐渐提高,优先选择本土供应商,有利于为公司提供了良好的市场机遇。国内通信设备制造商、消费电子品牌等企业在采购芯片时,开始加大对国产芯片的采购比例,公司可以抓住这一机遇,进一步扩大市场份额。

4)国家支持集成电路产业发展的相关政策

集成电路产业意义重大,已上升为国家战略,国家接连出台诸多支持政策。如2020年7月国务院发布的政策,从财税、投融资等八方面扶持集成电路企业;2021年3月的“十四五”规划等将集成电路列为重点攻关产业;党的二十大报告强调推动相关新兴产业融合发展;2024年7月中共中央决定强化集成电路等重点产业链发展。公司作为集成电路领域企业,这些政策为其带来发展契机。

展望2025年,随着人工智能、5G、大数据中心、新能源等新兴领域的迅速发展,将带动消费电子终端客户需求的回暖,以及随着新产品、新技术的创新发展,将提升电源管理芯片需求的增长。根据美国半导体行业协会(SIA)预估,2025年全球半导体销售额有望实现两位数增长。世界半导体贸易统计组织(WSTS)也预测,2025年半导体销售额将达到6,972亿美元。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于高性能、高品质的数模混合芯片设计。自成立以来,经过公司不断的研发和创新,在数模混合SoC集成技术、快充接口协议全集成技术、低功耗多电源管理技术、高精度ADC和电量计技术、大功率升降压技术、微型声重放系统等方面拥有深厚的技术积累。公司推出的电源管理芯片具有高集成度、高可定制化程度、高性价比、低可替代性的特点,能够缩短客户成品方案研发周期,简化客户产品生产过程,提升产品良率和可靠性,从而帮助客户优化成本并满足多样化的需求。产品受到了市场和行业的广泛认可。公司的快充协议芯片具有较强的市场竞争力,是获得全球首个OC5.0认证,首批Vooc SuperVooc授权厂商,取得PD认证芯片品类较多的厂商。因此,公司成为了消费电子市场主要的电源管理芯片和快充协议芯片供应商之一。报告期内产生销售收入的产品型号约400款,对应的产品子型号数量超过5000个,芯片销售数量超过17亿颗。公司合作的最终品牌客户包括小米、OPPO、vivo及三星等知名厂商。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)电源管理芯片领域

电源管理芯片堪称电子设备的“电能管家”,在各类电子产品中负责电能的变换、分配、检测及管理等关键任务,其性能优劣直接关乎电子设备的整体表现。如今,电源管理芯片凭借着广阔的终端应用领域,已然成为模拟芯片市场中最为重要的细分领域之一。近年来,随着芯片技术的创新与提升,应用范围还在持续扩张,不仅覆盖消费电子、汽车电子、计算机、工业控制等传统产业领域,更在人工智能、物联网、云计算、无线充电、新能源汽车、可穿戴设备等新兴市场获得新的机遇。终端应用的拓展推动着电源管理芯片向前发展,将促使厂商对电源管理芯片产生更大的需求,进一步拓宽电源管理芯片市场,为产业带来发展的新机遇。

1)储能电源市场

在全球能源短缺以及双碳目标的背景下,传统能源向清洁能源转型成为全球共识,目前全球已有130多个国家和地区相继提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标,实现绿色可持续发展已经成为全世界的广泛共识。随着我国“双碳”目标的快速推进,储能领域作为实现能源转型的关键环节,迎来了高速增长的黄金时期。储能系统在电力调峰、可再生能源消纳等方面发挥着重要作用,而电源管理芯片作为储能系统的核心组件,能够精准控制电池的充放电过程,提高能源利用效率,延长电池使用寿命。随着储能市场规模的不断扩大,电源管理芯片在该领域的应用前景十分广阔。

2)汽车电源管理市场

汽车行业正在不断向“电动化”和“智能化”发展,在上述趋势推动下,车载电源管理芯片的需求会逐渐增加,单辆汽车中的芯片价值量将会提升,汽车电源管理领域也会逐渐拓宽,汽车市场前景广阔。根据睿略行业研究,2022年全球汽车电子市场规模为830.86亿元,预测全球汽车电子市场规模在2028年将会达到964.43亿元,CAGR增长2.37%。新能源汽车的快速发展,更是带动了对电源管理芯片的需求,以满足各类电子设备的供电需求。

3)AI电源管理市场

随着人工智能和AIGC的快速发展,以AI服务器为核心的算力基础设施需求不断扩大。同时,GPU、CPU等算力芯片朝着更高性能升级也对供电系统提出更高要求。因此AI服务器的增长带动了电源管理芯片的需求,AI服务器电源管理市场空间广阔。根据QYResearch的统计及预测,2024年全球AI服务器电源系统市场销售额达到了3.17亿美元,预计2031年将达到6.03亿美元,年复合增长率(CAGR)为8.7%(2025-2031)。

随着AI技术的应用拓展不断扩大,在PC、手机、智能音箱、智能眼镜等终端设备上不断应用发展,用于AI的存储器产品需求强势,从而推动了存储电源管理芯片的需求增长,从而推动全球存储芯片市场规模将快速增长,根据中商产业研究院分析师预测,2024年全球市场规模将进一步增长至1529亿美元。

4)无线充电市场

近年来,随着技术迭代和消费者需求的变化,电子产品的充电需求逐渐附加技术、场景等多样性特征,无线充电技术应运而生。无线充电技术不需要匹配消费电子的充电插口型号,使用方便,极大满足了消费者的需求,市场规模得以稳步扩张。目前,无线充电技术主要应用在智能手机、笔记本电脑,可穿戴设备和厨房电器等电子设备,未来无线充电的应用进一步拓展至家具、家电、电动汽车等领域。根据中研普华产业研究院预测,到2029年,中国无线充电市场规模有望达到380亿元左右,2024至2029年年复合增长率为23%。

5)TWS耳机市场

近年来,随着TWS耳机在运动、学习、驾驶、搭乘交通工具等多元化场景应用的推广,TWS耳机需求量快速增长。根据Canalys发布的数据显示,2024年全球TWS耳机市场出货量达到3.3亿台,同比增长13%。未来,随着TWS音质续航等性能提升、运动状态监测和心率检测等功能丰富,以及技术的不断升级,都将带动TWS耳机市场需求。

6)可穿戴设备市场

随着AI、VR、AR等先进技术在可穿戴设备的普及,目前市场上主要的可穿戴设备的形态呈现多元化,如智能眼镜、智能手表、运动手环、可穿戴医疗智能设备、VR头戴智能设备等相关设备,未来随着互联技术的发展,将带动低功耗电源管理技术在可穿戴设备上的应用。根据Canalys的数据,全球可穿戴设备市场在2024年实现了稳定增长,出货量达到1.93亿台,同比增长4%。且根据IDC预计可穿戴设备到年底将增长至6.457亿台,到2028年复合年增长率(CAGR)为3.6%,这为电源管理芯片在可穿戴设备领域的发展提供了广阔的市场空间。

(1)快充协议芯片领域

随着消费者使用智能设备的时间越来越长,智能设备续航问题日渐突出。5G手机普遍比传统智能手机耗电更多。为了追求便携轻薄,智能手机的电池容量较难进一步提升,于是针对智能手机的快充技术应运而生。为了同时兼容普通充电器和不断迭代的大功率快充充电器,同时保证快充的安全性,在手机和快充充电器之间需要新增快充协议芯片,来沟通协调快充的电压/电流,应对各种异常状态的安全保护。英集芯研发了快充接口协议全集成技术,并在快充协议芯片的稳定性、安全性方面进行了深入研发。

1)快充电源适配器市场

近年来,随着智能移动设备功能的逐渐丰富,设备耗电量也随之上升。在设备配置的锂电池容量有限的情况下,智能设备快速充电功能的重要性逐渐增加,快充电源适配器市场逐渐得到消费者的关注,并在需求的不断带动下得以高速发展。随着快充电源适配器的推广,快充协议芯片作为快充电源适配器的重要部件,需求有望进一步提升。随着5G手机等智能终端设备的推广、快充电源适配器渗透率的提升,快充电源适配器市场发展迅速;此外,苹果等公司逐渐取消前装适配,第三方快充电源适配器市场也得到了进一步发展。

2)智能手机设备市场

支持快充协议的智能手机设备也需要用到手机端快充协议芯片。目前,快充手机在智能手机市场的渗透率不断上升,已经从高端机型渗透至中低端机型。同时,充电速度更快的快充协议也不断应用于新款智能手机,最新PD3.1快充协议的最大功率已从100W扩大至240W。未来随着AI大模型在手机上的使用,对于智能手机的快速充电功能要求日益重要,这也将推动快充协议芯片在智能手机领域上的发展。

3)平板电脑、笔记本电脑

随着AI PC的普及,将拉动更多消费者换机的需求。根据Canalys统计和预测数据,2024年兼容AI的个人电脑出货量占比有望从2023年的10%提升到19%,2027年预计提升至60%。支持快充功能的平板电脑、笔记本电脑的电源适配器端和设备端都需要使用快充协议芯片,是快充协议芯片的重要应用市场,未来快充协议芯片在该领域的需求有望持续增长。

4)电动工具

电动工具是快充协议芯片的重要应用市场之一。近年来,随着电钻、电动螺丝刀、冲击扳手等电动工具小型化、便携化的趋势,无绳类充电电动工具逐渐获得推广。支持快充功能的无绳电动工具的电源适配器端和设备端都需要有快充协议芯片。据PMI预测,电动工具市场预计在2024至2034年间将保持6%的年均复合增长率(CAGR),从2024年的382.036亿美元增长至2034年的684.188亿美元,这为快充协议芯片在电动工具领域的应用提供了广阔的市场前景。

5)智能家居设备市场

内置锂电池的智能音箱、智能灯、智能小家电等智能家居设备也是快充协议芯片的重要应用领域。支持快充功能的智能家居设备的电源适配器端和设备端都需要有快充协议芯片,随着智能家居市场不断优化升级,智能家居设备市场迎来新的发展机会。根据中商产业研究院分析师预测,2024年市场规模将达7848亿元,2025年市场规模将突破8000亿元,这将推动智能家居领域的需求增长。

(3)信号链领域

信号链芯片得益于应用场景广泛,下游需求带来信号链芯片发展新契机。近年来,在下游电子产品整机产量高速增长的带动下,中国信号链芯片市场保持稳定的增长。据Statista数据显示,2024年中国模拟集成电路市场收入预计将达268.4亿美元,且2024-2029年有望以9.68%的年复合增长率持续增长,到2029年市场规模预计可达426.1亿美元。下游应用领域广阔且相关应用终端发展繁荣,未来强劲的下游需求将是带动整个模拟芯片产业持续增长的强劲动力。

1)高速接口芯片市场

高速传输接口芯片是当代电子系统中承担系统互联、数据传输的核心元器件,随传输技术的发展持续迭代升级。在全球平板、手机、笔电、可穿戴设备、车载显示等市场不断发展下,终端设备数量和传输数据量高倍增长,推动了传输接口数量和种类的增加和变化,以及信号传输技术的发展换代。随着人工智能、万物物联、智能汽车等领域快速增长,全球流量引来爆发式增长。根据Cloudflare发布的年度回顾报告显示,全球互联网流量在2024年增长了17.2%,展现出了行业的蓬勃活力。大量数据的传输与交互,为高速传输接口芯片市场的快速发展提供了有力支撑,也将为高速接口芯片带来广阔的市场空间。

2)智能音频芯片市场

音频功放芯片,是各类音响器材中不可缺少的部分,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。随着应用设备的小型化,音频功放芯片逐步向智能化、节能化、高效率等方向突破演进,并通过与算法相结合,提升音频响度、清晰度和立体效果,同时对芯片和设备提供保护。随着手机、音响、车载、可穿戴设备、计算机设备、智能家居等下游应用领域的需求扩张。根据Canalys数据显示,2024年全球个人智能音频设备(包括TWS、无线头戴式耳机和无线颈挂式耳机)的出货量达到4.55亿台,同比增长11.2%。未来,音频功放芯片行业终端应用景气度蓬勃。

3)BMS市场

受益于快充技术的迅速发展,电动车、智能家居、便携式储能的产品持续放量,BMS作为关键的核心部件,需要更高的性能和可靠性,未来BMS芯片会有更加广阔的市场空间。据QYR统计与预测,2024年全球BMS市场销售额攀升至106.7亿美元。展望未来,到2031年这一数字有望跃升至657.3亿美元,在2025-2031年期间,年复合增长率(CAGR)可达30.1%。在当下,BMS的创新与升级,将开拓出潜力巨大的市场机遇。

综上所述,电源管理芯片、快充协议芯片和信号链芯片在各自的应用领域均展现出强劲的发展势头。随着科技的不断进步和市场需求的持续变化,这些芯片领域有望在未来继续保持增长态势,为国产半导体产业的发展注入源源不断的动力,同时也将为众多相关行业的创新升级提供有力支持。无论是在传统产业的数字化转型,还是新兴科技领域的开拓创新中,这些芯片都将发挥不可或缺的重要作用,成为推动全球科技进步的关键力量。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,127,372,885.77	1,983,660,889.53	7.24	1,872,024,594.19
归属于上市公司股东的净资产	1,987,495,239.87	1,830,418,154.26	8.58	1,756,071,644.65
营业收入	1,430,516,298.72	1,216,775,044.39	17.66	867,261,374.92
归属于上市公司股东的净利润	124,250,617.15	29,373,348.62	323.00	154,913,056.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,802,450.40	15,640,087.97	608.48	143,389,729.58
经营活动产生的现金流量净额	233,896,798.98	38,090,179.23	514.06	-42,039,684.56
加权平均净资产收益率(%)	6.60	1.66	增加4.94个百分点	11.31
基本每股收益(元/股)	0.29	0.07	314.29	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.07	314.29	0.38
研发投入占营业收入的比例(%)	21.15	28.18	减少4.03个百分点	19.26

注:剔除股份支付费用影响后,归属于上市公司股东的净利润为168,653,027.14元,较上年同期增长20.38%。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	261,185,656.84	357,488,355.41	405,206,102.49	406,637,383.98
归属于上市公司股东的净利润	3,962,487.41	35,097,093.06	49,994,356.77	35,206,680.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,498,870.62	32,353,880.98	46,306,030.88	29,643,667.92
经营活动产生的现金流量净额	-133,491,464.10	-12,978,649.92	206,375,206.17	173,991,707.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,575
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,569
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
珠海英集投资合伙企业(有限合伙)	0	104,535,837	24.35	104,535,837	无	0	其他
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	0	104,188,785	24.27	0	无	0	其他
北京芯动能投资基金(有限合伙)	-2,123,973	33,214,922	7.74	0	无	0	其他
珠海英芯投资合伙企业(有限合伙)	0	14,341,564	3.34	14,341,564	无	0	其他
共青城科苑股权投资合伙企业(有限合伙)	-5,984,624	13,163,112	3.07	0	无	0	其他
上海科技创业投资有限公司	2,600,000	7,069,470	1.65	0	无	0	国有法人
成都英集芯企业管理合伙企业(有限合伙)	0	6,925,208	1.61	6,925,208	无	0	其他
共青城诚想投权投资合伙企业(有限合伙)	-3,013,787	6,901,566	1.61	0	无	0	其他
黄凯伟	120,000	4,839,433	1.13	4,569,433	无	0	境内自然人
陈鑫	30,000	2,632,327	0.61	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海英集投资合伙企业(有限合伙)、珠海英芯投资合伙企业(有限合伙)、成都英集芯企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动关系,其执行事务合伙人均为公司实际控制人黄洪伟;共青城科苑股权投资合伙企业(有限合伙)、共青城诚想股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动关系,其基金管理人均为上海兴锐投资管理有限公司。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

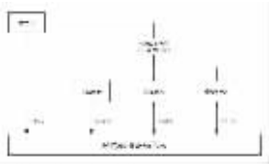
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入1,430,516,298.72元,较上年同期增长17.66%;实现归属于上市公司股东的净利润124,250,617.15元,较上年同期增长323.00%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润110,802,450.40元,较上年同期增长608.45%。

报告期末,公司总资产2,127,372,885.77元,较上年度末增长7.24%;归属于上市公司股东的净资产1,987,495,239.87元,较上年度末增长8.58%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688209　证券简称:英集芯　公告编号:2025-022

深圳英集芯科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称“公司”、“英集芯”)第二届监事会第十一次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席林丽萍女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

(一)审议通过《关于(公司2024年度监事会工作报告)的议案》

监事会认为:2024年,公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交至2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于(公司2024年度财务决算报告)的议案》

监事会认为:公司2024年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定,公允地反映了公司截至2024年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已完成对公司2024年度财务报表审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交至2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于(公司2024年年度报告)及其摘要的议案》

经审核,公司2024年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,2024年年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项;公司2024年年度报告及其摘要编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交至2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2024年年度报告》及《英集芯2024年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于(公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司2024年度募集资金存放和使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-024)。

(五)审议通过《关于(公司2024年度内部控制评价报告)的议案》

《公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况,监事会同意《关于(公司2024年度内部控制评价报告)的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯2024年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。综上,监事会同意本次年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交至2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯关于2024年度利润分配预案公告》(公告编号:2025-025)。

(七)审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及监事薪酬,全体监事需回避表决,直接提交至2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英集芯关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-026)。

(八)审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:本次使用剩余超募资金人民币7,674.68万元永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,符合公司发展战略和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定,履行了必要的审议程序,不会影响公司募集资金投资项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常开展,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用剩余超募资金人民币7,674.68万元永久补充流动资金,并同意提交至股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交至2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《英集芯关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-027)。

(九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《英集芯关于使用闲置自有资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2025-028)。

(十)审议通过《关于(公司2025年第一季度报告)的议案》

监事会认为:公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,2025年第一季度报告的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项;公司2025年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《英集芯2025年第一季度报告》。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:688209　证券简称:英集芯　公告编号:2025-025

深圳英集芯科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A股每10股派发现金红利0.90元(含税),本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润124,250,617.15元;截至2024年12月31日,母公司未分配利润为480,882,091.79元。经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后为基数,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本429,238,405股,以扣除公司回购专用证券账户中股份数3,980,907股后的股本425,257,498股为基数,以此计算合计派发现金红利38,273,174.82元(含税),占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.80%。

2024年度公司以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额43,128,994.06元(不含交易佣金等交易费用),现金分红和回购金额合计81,402,168.88元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例65.51%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计38,273,174.82元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.80%。

2024年度公司不送红股,不进行资本公积转增。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,拟以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

●本次利润分配不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

| 项目